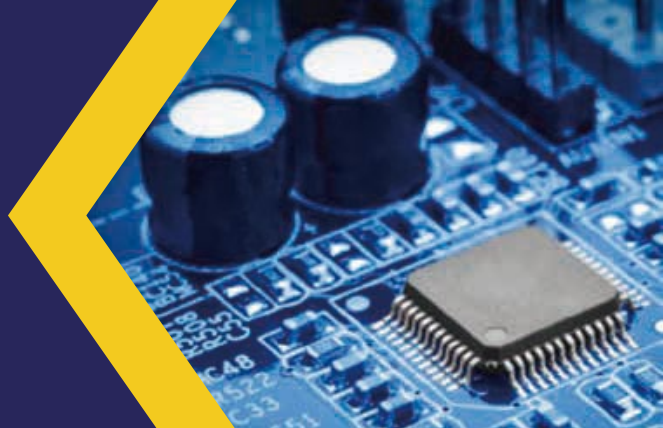


第66回 IEEE EPS Japan Chapter イブニングミーティング

くまもと3D 連携コンソーシアム

第7 回オープンセミナー

2025 年9月19 日(金)15:00～



3次元半導体集積実装および周辺技術

- ◆ オンサイトおよびZoom のハイブリッド開催
- ◆ 会場:熊本大学黒髪南地区 工学部百周年記念館

※大学内には十分な駐車スペースがありません。
公共交通機関をご利用ください。

主催:IEEE EPS Japan Chapter
共催:くまもと3D 連携コンソーシアム
協賛:一社 エレクトロニクス実装学会
国立大学法人熊本大学

今回の オープンセミナーは、IEEE EPS Japan Chapterのイブニングミーティングと共同で開催します。
半導体 3D 実装技術および光電融合デバイスに関する実装技術について最新の研究開発動向を第一線で活躍
されている講師の方に講演して頂きます(1 件は英語でのオンライン講演です)。
熊本大学黒髪南地区でのオンサイトと Zoom のハイブリッド開催です。

講演詳細は <https://www.ieee-jp.org/section/tokyo/chapter/CPMT-21/2025/20250919/index.html> をご覧下さい。

◆ プログラム

- ・ くまもと3D 連携コンソーシアムと熊本大学オープンラボ「SOIL」のご紹介
熊本大学 卓越教授 青柳 昌宏 氏
熊本大学 教授 緒方 智成 氏
- ・ ヘテロジニアス集積に向けた常温・低温接合技術の動向とデバイスの高度化
東北大学 教授/エレクトロニクス実装学会 会長 日暮 栄治 氏
- ・ マイクロトランスファープリンティング技術による異種材料光チップレット集積
産業技術総合研究所 上級主任研究員 高 磊 氏
- ・ ガラス基板上光電集積プラットフォーム及び樹脂3D プリントによる微細光接続技術
住友電気工業株式会社 水野 泰孝 氏
- ・ Scaling PIC packaging for high volume CPO applications
Intel Corporation Dr. Nick Psaila
英語での講演です。同時通訳等はありません

◆ 参加費

くまもと3D 連携コンソーシアム会員企業等に所属の方:無料

IEEE EPS 会員:無料 IEEE 会員:1,000 円 JIEP 会員:3,000 円 一般:4,000 円

◆ 交流会(17:50～)

会費:2,000円

会場:熊本大学 黒髪南地区熊本大学生協 FORICO

◆ 参加申込

下記フォームから9月12日までにお申し込みください。

<https://forms.gle/u8372TfUoFHNiq1i8>